ダイトウ テクノグリーン株式会社

～ チップマルチ敷設地の植栽用袋 ～

プラントマネージャー

土壌充填時の状態

現場設置後の状態

チップマルチ敷設地における植栽の問題点

1. 苗木植栽後にチップマルチ敷設 → 作業効率の悪化、作業時の苗木の損傷
2. チップマルチ敷設後の苗木植栽 → 施工が手間（チップマルチをかき分けて植栽するため）
3. 埋戻土へのチップ混入 → 微生物によるチップ分解の際に、土壌中の窒素分消費による窒素飢餓

“プラントマネージャー”の特徴

1. チップマルチを敷設後の植穴掘削手間を省略
2. 本体に不透水性シートを用いることによる初期生育時の乾燥防止効果
3. チップマルチと植栽部の土壌が接するのを防ぐことで、窒素飢餓の影響が苗木に及ぶのを防止
4. 本体上部に水飲み穴があり、集水能力アップ
5. 元地盤（地山）へ根系が進出できるように、底面には腐食性の麻布を使用
6. 現地で運搬しやすいよう取っ手付き

側面は不透水性シート

底面は麻布

プラントマネージャー　施工手順

チップ敷設前

土壌15ﾘｯﾄﾙ充填、設置場所に運搬

のり面に設置し、アンカーで固定

チップが袋内に入らぬよう閉口

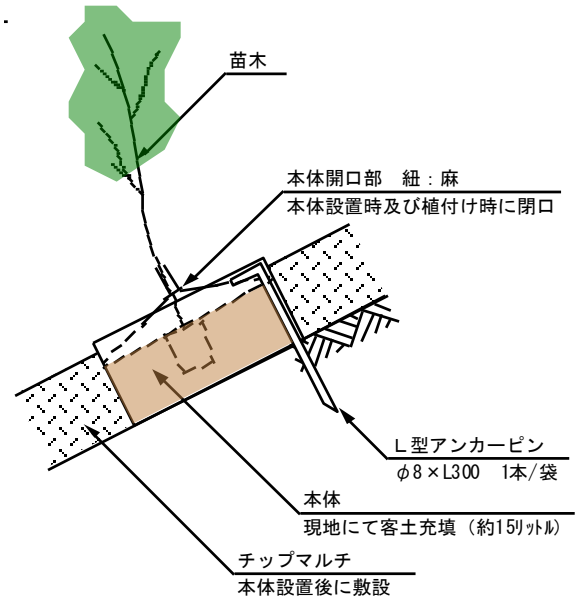
チップ敷設後

チップ敷設後に開口

本体に苗木を植付け、灌水後に閉口

周囲のチップを均し設置完了

プラントマネージャー　設置標準図



設置時側面図

製品仕様

規格　外径：約φ350mm
　　高さ：約410mm（閉口時 約170mm）

材質　外装：ポリエチレンラミネートクロスシート
　　底面及び紐：麻

固定ピン：L型アンカーピン　φ8mm　L=300mm
（本体1袋当たり1～2本必要）

注意事項：

※ 本製品には客土及び苗木は含まれておりません。

※ 底面の麻布は濡れると分解がはじまるので、客土充填後は、速やかに植栽箇所へ設置して下さい。

※ 製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

■ 製造・販売元
ダイトウ テクノグリーン株式会社
〒194-0013
東京都町田市原町田1丁目2番3号
TEL:042-721-1703 FAX:042-721-0944
https://www.daitoutg.co.jp/
E-mail:info@daitoutg.co.jp